

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND

KEMIALISESTI KOVETTUVA SIDOSAINE



EI ODOTUSTA - EI VALOTUSTA

1 Kaikkiin toimenpiteisiin

2 Kaikille tekniikoille

3 Kaikille materiaaleille

Uutuus!

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND

- Kaikkiin suoriin ja epäsuoriin tekniikoihin
- Sopii käytettäväksi itse-etsaus-, total-etch ja selektiivisen kiille-etsauksen tekniikoissa
- Yhteensopiva valokovetteisten, kemiallisesti kovettuvien ja kaksoiskovetteisten materiaalien kanssa
- Ei valokovetusta
- pH 2.2
- Ei erillistä primeria keramialle
- Ohut filmin paksuus 5-10 µm takaa esteettisen lopputuloksen
- n. 250 applikaatiota / A+B



SEKOITA TIPAT A+B



SUORA TEKNIikka



APPLIKOI SIDOSAINE

EI ODOTUSTA



ILMAPUUSTAA KEVYESTI

EI VALOTUSTA



VIE TÄYTEMATERIAALI

EPÄSUORA TEKNIikka



APPLIKOI SIDOSAINE



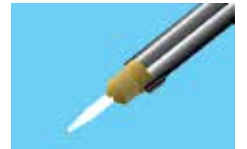
HAMPAALLE JA
SEMENTOIVALLE
RESTAURAATIOLLE

EI ODOTUSTA



ILMAPUUSTAA KEVYESTI

EI VALOTUSTA



SEMENTOI

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND KIT

- Universal Bond A 5 ml
- Universal Bond B 5 ml
- Sekoituskuppi
- 5 x kertakäyttöinen sekoituskuppi
- 25 x applikaattori

TIL.NRO 109120



TOKUYAMA UNIVERSAL BOND A 5 ml

TIL.NRO 109121

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND B 5 ml

TIL.NRO 109122



Dental Systems

Tilaukset:

Puh. 020 1772 300
info@dentalsystems.fi
www.dentalsystems.fi

Niitylänpolku 16
00620 Helsinki